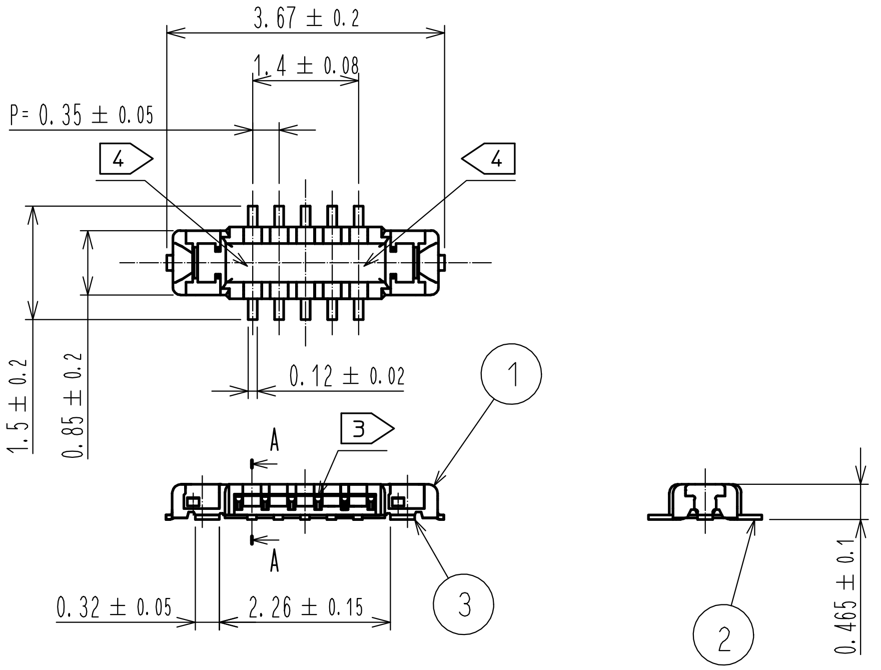
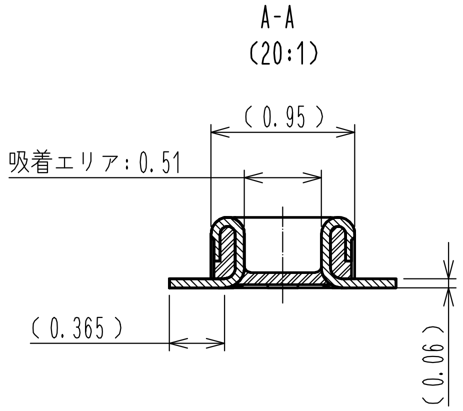
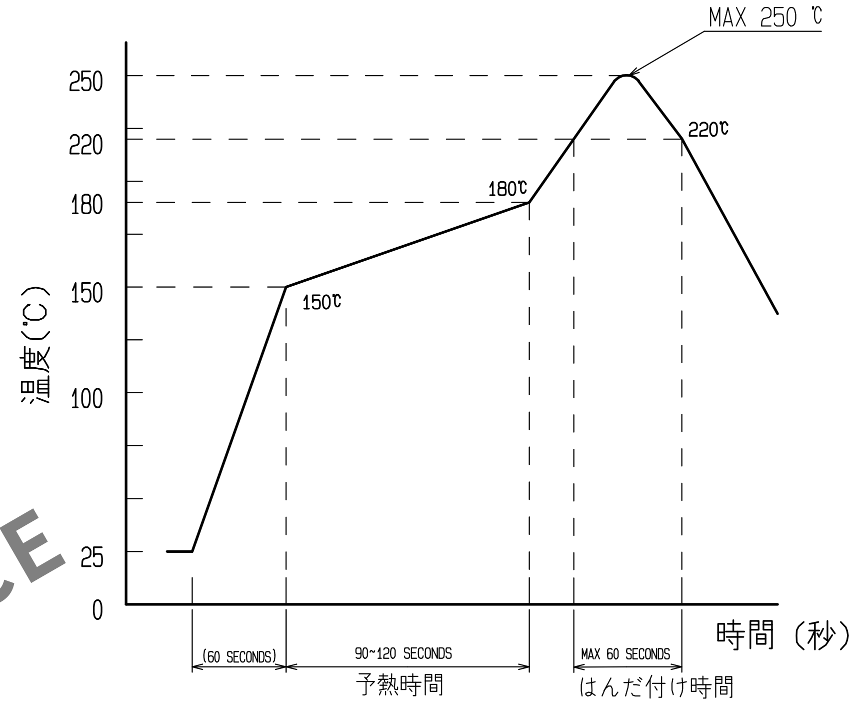


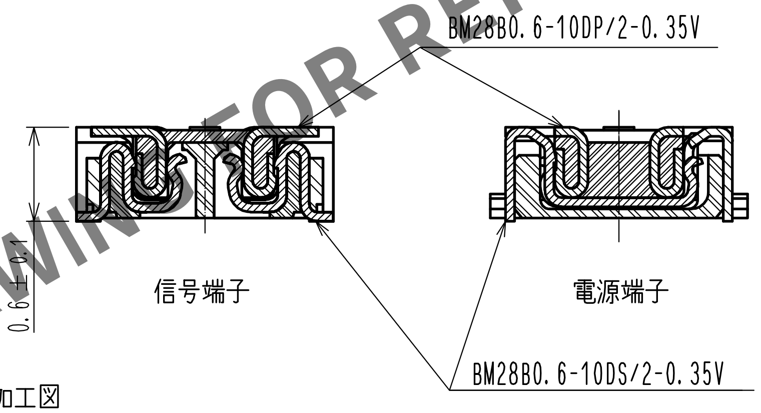


5> 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル(推奨)



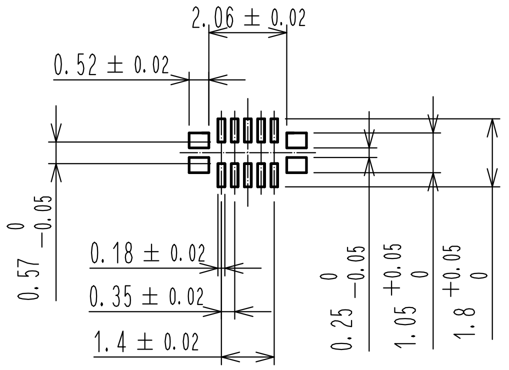
リフロー方式：IRリフロー
リフローは2回以下とします。
1)リフロー部
220℃以上　60秒以下
(ピーク温度250℃)
2)プリヒート部
150～180℃　90秒～120秒

嵌合断面図 (20:1)

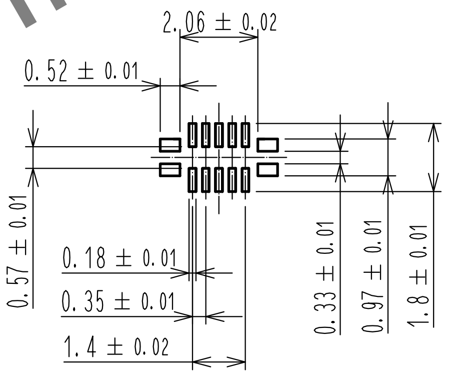


注　1．平坦度は0.08mm以内です。
2> めっき仕様
　接触部　：金めっき0.05μm以上
　リード部　：金めっき0.05μm以上
　下地　：ニッケルめっき1μm以上
　（表面　：封孔処理）
3> 製品側面に凹みを設ける場合があります。
4> 図示近辺にHRSマーク又はCAV No.を表示します。

◆推奨パターン図
(ランドパターン)

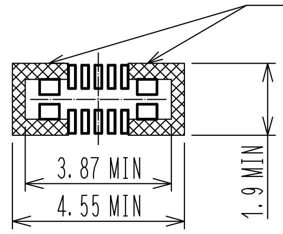


◆メタルマスク開口部推奨加工図
メタルマスク厚さ：80μm



◆推奨パターン図
(コネクタ周辺の部品)

▨部は嵌合エリアとなります。
嵌合に影響を及ぼす部品配置はしないようお願い致します。



5> この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
追加要因:クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、
その他実装部材等の条件により異なる場合がありますので、
実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。
温度は端子リード部にて測定しています。
6. 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社に
ご連絡を下さい。
7. この製品は、最大900ppmの塩素、最大900ppmの臭素、
および最大1500ppmの塩素と臭素の合計として定義されている
ハロゲンフリー要件を満たしています。
8. この製品はRoHSに準拠しています。

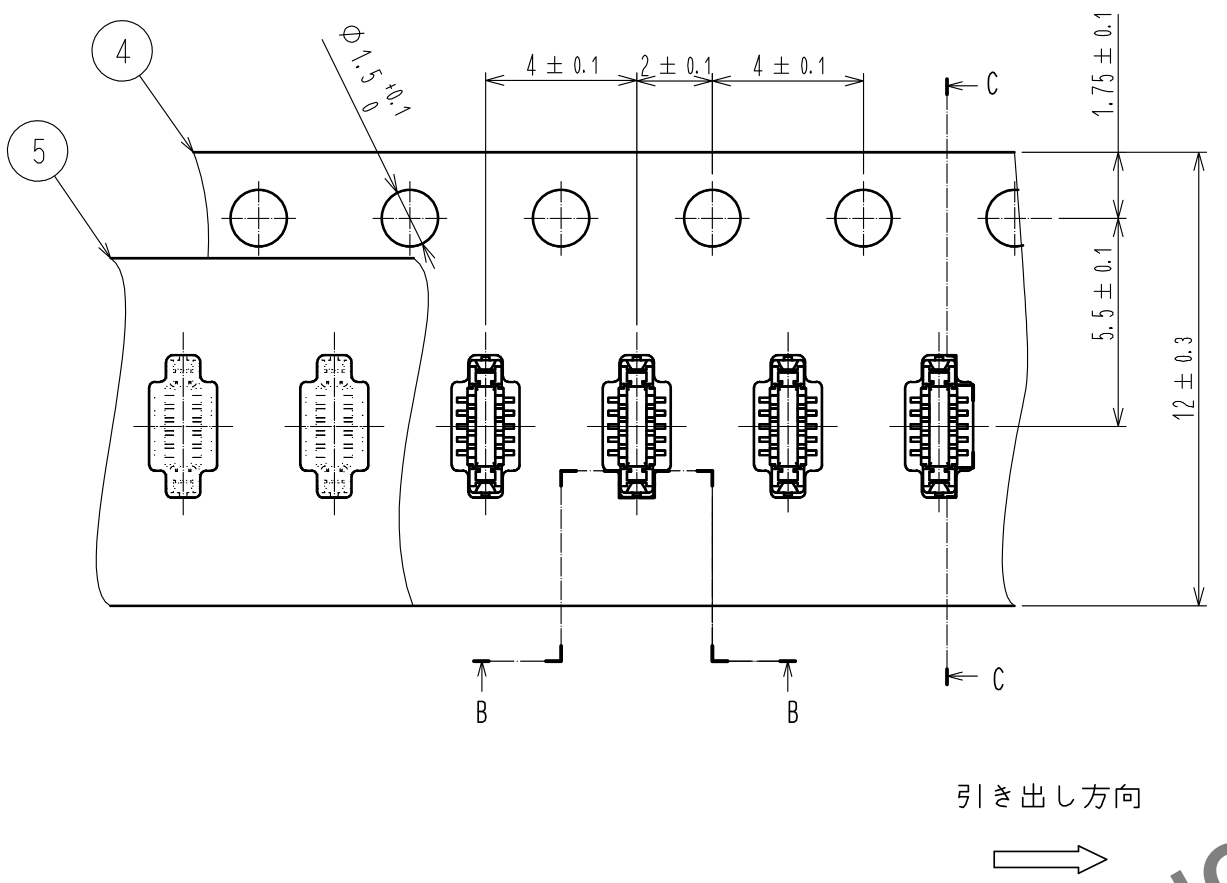
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
4	PS	CLEAR(エンボスキャリアテープ)			
3	銅合金	2>	7	PS	CLEAR(補強用カラー)
2	銅合金	2>	6	PS	BLACK(プラスチックリール)
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	10 : 1	△1	1	DIS-H-00010654	KH. ODA	TS. MIYAZAKI	20210908

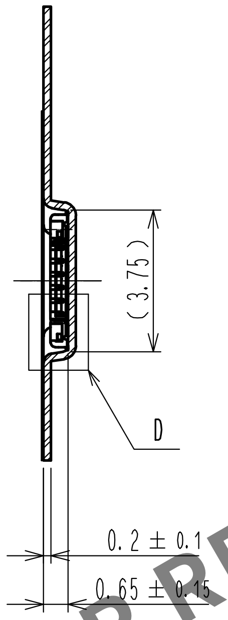
HIROSE
ELECTRIC
CO., LTD.

APPROVED	WR. FUKUCHI	20200116	DRAWING NO. ADC-365297-53-00
CHECKED	TS. MIYAZAKI	20200116	PART NO. BM28B0.6-10DP/2-0.35V(53)
DESIGNED	KT. KUSAKA	20200116	CODE NO. CL0673-5043-0-53 △1 1/3
DRAWN	MN. SATOH	20200116	

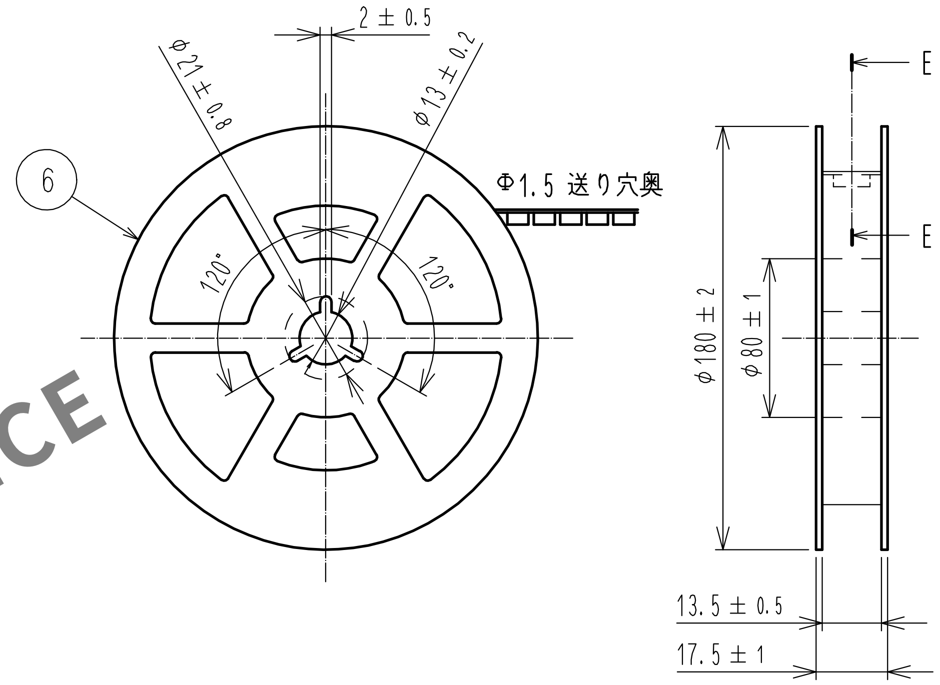
エンボスキャリアテープ (5:1)



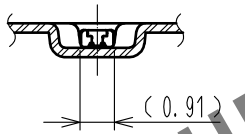
C-C (5:1)



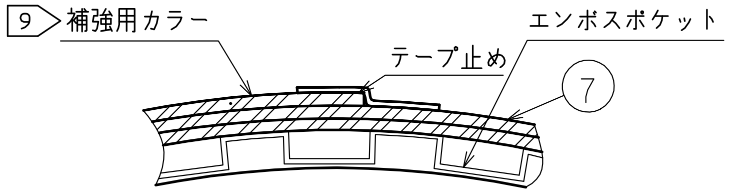
リール形状および寸法 (Free)



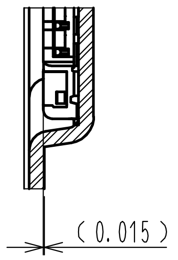
B-B (5:1)

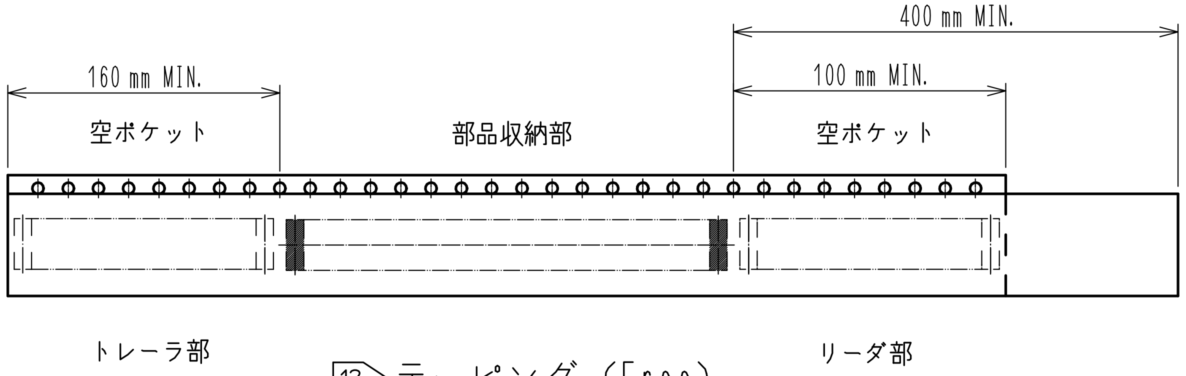


E-E (Free)



D (10:1)





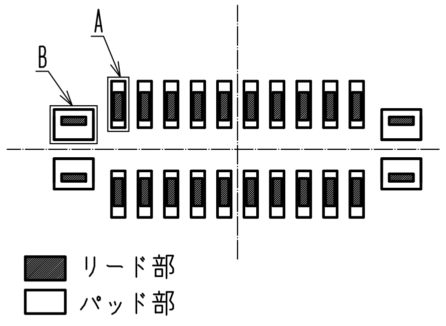
⑫ テーピング (Free)

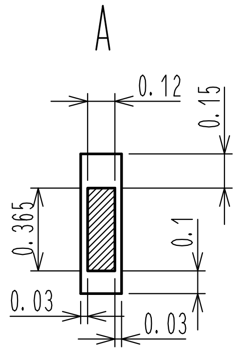
⑨ 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。
10. 1リール1,000個巻きです。
11. ( )内寸法は参考寸法です。
⑫ エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。

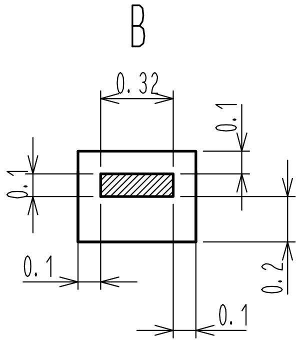
HRS		
	DRAWING NO.	ADC-365297-53-00
	PART NO.	BM28B0.6-10DP/2-0.35V(53)
	CODE NO.	CL0673-5043-0-53
	△1	2/3

⚠１３．各注意点の詳細については、本シリーズガイドライン：ＡＴＡＤ－Ｈ１０１６をご参照ください。

基板パターンとコネクタの位置関係について







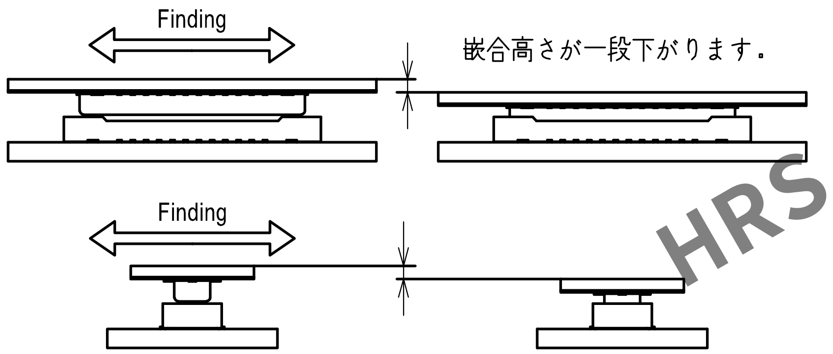
コネクタの嵌合方法に関して

本製品を嵌合させる際は、手で嵌合頂くようお願い致します。

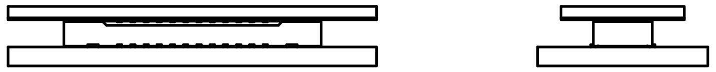
嵌合の手順

（１）誘い込みを手探りで探して、位置合わせを行って下さい。
本製品は嵌合をうまく誘い込む為、誘い込みのガイドリブを設けています。
位置合わせが出来ますと、コネクタが誘い込まれます。
誘い込まれると、コネクタの嵌合高さが一段下がるのが、手感触でわかります。

コネクタを前後左右に動かし誘い込み口を探してください。



（２）誘い込まれた状態では、コネクタ同士が平行になっており、前後左右にコネクタを
動かすことができない状態になっています。この状態から、嵌合を最後まで行って下さい。

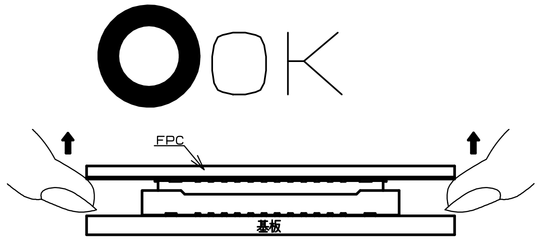


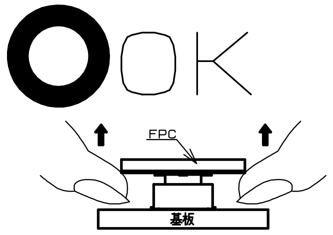
（３）嵌合が最後まで行われているか確認をしてください。
片側が浮いている場合や斜めに嵌合されている場合は、一度嵌合を外し、再度嵌合し直して下さい。

コネクタの取り外し方法に関して

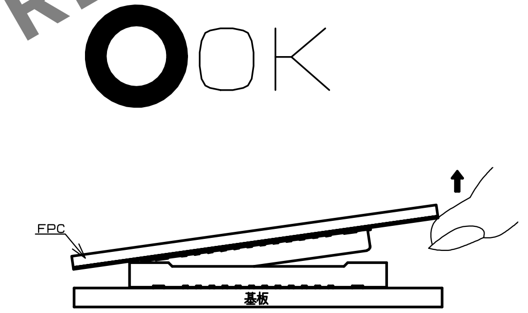
本製品を嵌合させる際は、手で嵌合頂くようお願い致します。

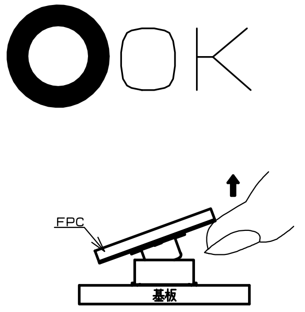
（１）コネクタを取り外す際は、コネクタ搭載面に対して垂直報告に抜くのが望ましいですが、
基板対ＦＰＣでの取り外しの場合は、多極になればなるほど、また、ＦＰＣの厚みが薄いと、垂直方向に
取り外すのは困難になります。

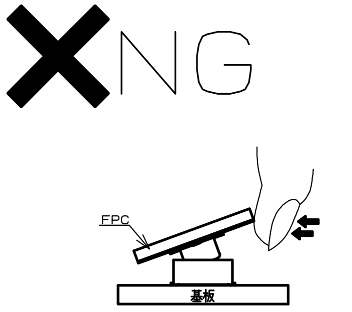




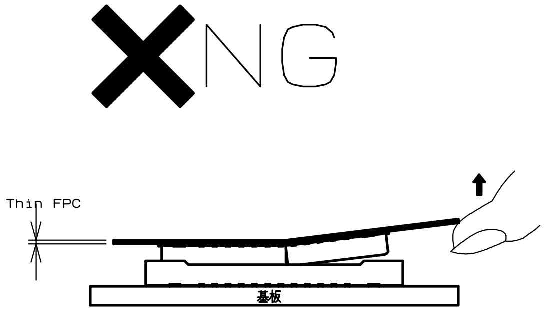
（２）取り外しが困難な場合は、ピッチ方向側に斜めに取り外して下さい。
幅方向側からの取り外しは端子に大きな負担がかかりますので、ご注意下さい。
なお、幅方向から取り外す場合はＦＰＣの端を垂直方向に引っ張り取り外して下さい。
（水平方向へ力が加わると端子に大きな負担が掛かります。）

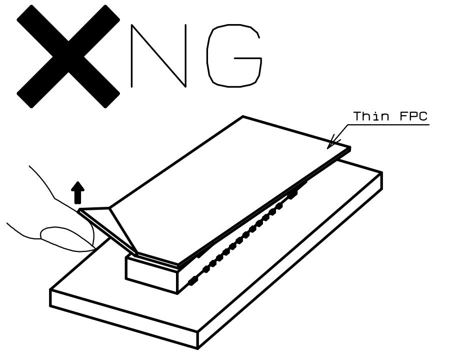






（３）ＦＰＣに十分な剛性がない場合は、はんだ剥離、コネクタ折れが発生する場合がありますので、
試作時など事前にご使用頂くＦＰＣで繰り返し動作を確認の上、ご使用をお願い致します。
また、ＦＰＣのコーナー部を持って、斜めに取り外すと、端子に大きな負担が掛かりますので、
行わないで下さい。





HRS	DRAWING NO.	ADC-365297-53-00
	PART NO.	BM28B0.6-10DP/2-0.35V(53)
	CODE NO.	CL0673-5043-0-53 ⚠ 3/3